

深圳市龙图光罩股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：龙图光罩

证券代码：688721

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	易方达、国海电子、宝银基金、民生电子、中银国际、山西证券、中颐资本
时间	2024年10月24日星期四下午2:30
地点	珠海市龙图光罩科技有限公司大楼四楼会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书、财务总监：范强 2、总经理助理：邓少华 3、证券事务代表：李建东
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况</p> <p>深圳市龙图光罩股份有限公司成立于2010年，是具备关键技术攻关能力，拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商。</p> <p>公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线，不断进行技术攻关和产品迭代，半导体掩模版工艺节点从1μm逐步提升至130nm，产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等特色工艺半导体领域，终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。</p> <p>公司于2022年8月设立珠海市龙图光罩科技有限公司，紧随国家半导体行业发展战略，围绕高端半导体芯片掩模版领域，持续加大研发投入，逐步实现90nm、65nm以及更高节点掩模版的量产与国产化配套，深耕特色工艺，突破高端制程，立志成为国际一流的半导体光罩企业。</p>

二、投资者互动交流

1、公司目前产能利用率情况以及珠海的产能规划？深圳工厂是否有扩产计划？

回复：公司目前主要产能集中在深圳工厂，深圳工厂 2023 年度的产能利用率为 82.63%，募投项目珠海工厂达产后第三代半导体掩模版产品预计为 1.8 万片。深圳目前暂无扩产计划，但未来会视市场整体情况考虑是否扩产或是在珠海扩产。

2、公司珠海募投项目进度如何？哪些设备已经到厂了？都处于什么情况？新建厂是否存在良率爬坡？如何维持良好盈利情况？公司设备折旧时间？

回复：珠海募投项目目前处于工艺验证和客户送样阶段，目前电子束光刻、干法刻蚀、检测等主要生产设备均已到厂完成安装调试，第四季度进行小批量试产。

公司已开展了第三代半导体掩模版的技术的研究与储备，包括 PSM 掩模版数据处理技术研究、二次光刻的精准对位研究、二次涂胶与烘烤工艺研究、PSM 相移掩模版的灰度检测方法研究等，涉及第三代掩模版的 CAM、光刻、检测全环节，已取得了一定的技术成果，形成多项知识产权与专有技术。

公司关键生产设备的折旧时间为 10 年，募投项目存在一定的折旧压力，如相应产品能够顺利验证逐渐上量，预计良率和产能爬坡能够按计划达成。

3、公司在更先进制程产品上的规划和节奏？制程再往上走最难的是什么？

回复：珠海募投项目预计在今年年底实现第三代半导体掩模版的小规模试产，预计于 2025 年实现稳定量产，目前已启动 28nm 制程节点的规划。

往更高的制程节点突破，主要难度：（1）随着半导体工艺的不断提升，掩模版的要求也越来越苛刻，因此半导体掩模版对最小线宽、位置精度、CD 精度、缺陷管控等均提出了更高的要求，工艺难度大，技术壁垒高。（2）在掩模版线缝水平的不断提升的要求下，下游晶圆在使用光刻机曝光时光学效应影响越发显著，会出现实际光刻图案与芯片设计图案失真变形的现象，严重影响芯片的性能与良率。（3）若是达到了先进制程，如 28nm 及以下，需要国内产业链上下游的协同，目前国外的贸易限制和技术封锁，先进制程的生产设备在一定程度上受到限制。

4、公司有无并购重组的计划？

回复：目前公司正专注于现有业务的稳定发展和提

升核心竞争力。如果市场上存在一些优质资产的机会，公司会结合估值情况及财务状况综合考虑，以实现公司的长期增长目标。

5、怎么看待公司盈利和利润的可持续性？

回复：公司盈利和利润是可持续的，理由如下：（1）行业的发展。新能源汽车、光伏发电、物联网、工业智造等为代表的终端市场需求快速增长，推动特色工艺半导体需求大幅增长，带来对相应掩模版的需求大幅增加。（2）贸易限制。在当前贸易摩擦、半导体产业逆全球化的背景下，国内特色工艺晶圆制造厂商也在纷纷积极寻求与国内掩模版供应商的合作，以实现对外国厂商的进口替代。（3）公司的技术水平。半导体掩模版制程、精度和缺陷控制要求高，公司具备较强的技术工艺水平及持续技术研发能力满足客户多样化需求。（4）客户黏性高。半导体掩模版为芯片制造环节关键材料，下游客户对供应商考核严苛且认证周期长，客户黏性较高。

在费用管理方面，公司募投项目的实施前期研发投入会高一些，但管理费用和销售费用较稳定，甚至可能随着规模效应下降，半导体掩模版主要是技术和研发驱动，销售费用也相对可控。

6、如何理解公司产品需求的稳定性或是在一定程度上抗周期的属性？

回复：半导体掩模版具有部分逆行业周期特性，当半导体行业处于下行周期时，晶圆制造厂商的产能利用率不足时，为了提升产能利用率，晶圆制造厂商会向众多的中小芯片设计公司提供晶圆代工服务，从而生产的半导体产品类型亦会增多，相应增加掩模版的需求量；同时当下游需求低迷时，芯片设计公司将通过设计新产品刺激市场，提升销量，新产品也会带来对掩模版的增量需求。上述行为是半导体掩模版上下游企业面对行业下行时的应对措施，一定程度上会降低半导体掩模版由于行业下行带来的需求下降影响，但并不会从根本上逆转半导体掩模版行业受大产业周期影响趋势。在行业的周期波动中仍能保持一定的需求稳定性，是半导体掩模版部分逆行业周期具体体现。

7、公司毛利率较高的原因，为什么高于国外厂商？

回复：一方面，半导体掩模版呈现“高精度、多品种、小批量”特点，产品精度要求更高且客户较为分散，掩模版厂商议价能力较强，定价水平较高；另一方面，掩模版为下游晶圆制造的工具，成本占整体晶圆制造成

	<p>本比例较低，但对晶圆的质量影响巨大，因此，下游客户更注重产品品质、对价格的敏感度相对较低，毛利率水平相对更高。国外厂商的毛利率略低的主要原因系其产品制程水平较高，固定资产投资规模更大，相应的折旧压力更高；另外系其用工成本、运营成本等显著高于国内水平。</p> <p>8、公司对于人才培养和激励机制的计划？</p> <p>回复：公司持续建设并完善人才选拔、培养与使用体系，将人才培养作为公司重点工作。一方面，公司通过校园招聘、社会招聘不断引进人才，壮大研发队伍；另一方面，积极鼓励员工参与行业协会、科研机构举办的培训与活动，对员工进行专业化培训，加速人才的成长。同时，为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司未来将适时对骨干员工进一步实施股权激励，有效地将公司利益和员工利益进行结合。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 10 月 24 日星期四